

REPORTE DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Juan Marcelo Miranda Gómez

PUESTO: Profesor Investigador

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Electromecánica Industrial

LUGAR DE LA COMISIÓN: Expopack Guadalajara 2017

PERIODO DE LA COMISIÓN: 13-15 de junio de 2017

RESULTADOS OBTENIDOS:

Los alumnos de la carrera de Mecatrónica de los grupos MEC31, MEC32 y algunos alumnos del grupo MEC61 vieron los adelantos tecnológicos de empaquetado y embalaje que existen actualmente en la industria, dándoles una visión clara del campo laboral y las nuevas tecnologías que deben aprender para emplearse en la industria. Así mismo los alumnos contactaron algunas empresas donde pueden realizar su estadía con apoyo económico.

CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCIÓN:

Se contactó a empresas que pueden aceptar a alumnos de estadía proporcionando apoyo económico y realizar vinculación entre la Universidad y estas empresas, ya que ofrecieron sus instalaciones para realizar visitas guiadas para alumnos de las diferentes carreras de la Universidad. También se identificaron algunos proveedores de nuevas tecnologías de bajo costo.

CONCLUSIONES:

Se vieron los adelantos tecnológicos y proveedores de nuevas tecnologías y se dio un acercamiento de los alumnos con empresarios de estas tecnologías de avanzada para realizar vinculación.
